**Premier Farnell ahora tiene el nuevo Raspberry Pi Compute Module 3+**

*La versión actualizada del Compute Module ofrece el rendimiento térmico mejorado del Raspberry Pi 3 Modelo B+ en un factor de forma más pequeño con cuatro variantes de memoria y un rango de temperatura operativa más amplio*

**Chicago, Illinois, 28 de enero de 2019:** [Premier Farnell](https://www.premierfarnell.com/), el distribuidor de referencia, ahora tiene el nuevo Raspberry Pi Compute Module 3+ disponible para despachar el mismo día. El Raspberry Pi Compute Module 3+ ofrece el rendimiento térmico mejorado y la facilidad de uso de la Raspberry Pi 3 Modelo B+ en un factor de forma más pequeño, con una selección de variantes de memoria apta para una amplia gama de aplicaciones embebidas que incluye dispositivos del IoT y sistemas de automatización industrial, monitorización y control.

El Raspberry Pi Compute Module 3+ se basa en el procesador de aplicación Broadcom BCM2837B0 de 64 bits que funciona a 1,2 GHz con SDRAM LPDDR2 de 1 GB. Los diseñadores ahora pueden elegir entre las variantes de Flash eMMC de 8 GB, 16 GB y 32 GB y la variante ‘Lite’ sin Flash eMMC, para responder a sus requisitos de almacenamiento.

“Los clientes continuamente nos dicen\* que lo que hace a la Raspberry Pi tan atractiva al momento de seleccionar una placa de desarrollo es su facilidad de uso. Más de una tercera parte\* de nuestros clientes de Raspberry Pi utiliza la placa para uso profesional”, **ha dicho Hari Kalyanaraman, Global Head of SBC and Emerging Business de Premier Farnell y Newark element14**. “Esta nueva versión del popular Raspberry Pi Compute Module ofrece facilidad de uso además de un rendimiento térmico mejorado y una mayor flexibilidad mediante múltiples variantes de memoria. Los diseñadores ya no tienen que personalizar sus placas si necesitan memoria adicional, y pueden comercializar su producto más rápido que nunca”.

**Eben Upton, CEO of Raspberry Pi Trading, ha dicho** “Con el lanzamiento de hoy del Raspberry Pi Compute Module 3+, podemos ofrecer una gama completa de ordenadores de placa única y productos de sistema en módulo, basada en el dispositivo Broadcom BCM2837B0 más reciente de excelente rendimiento. El Compute Module 3+ es apto tanto para makers como para ingenieros profesionales y ofrece un rendimiento térmico mejorado, un intervalo de temperatura ambiente más amplio, más opciones de almacenamiento y acceso a la comunidad y el ecosistema software líderes a nivel mundial de Raspberry Pi”.

Las características destacadas del Raspberry Pi Compute Module 3+ incluyen:

* Procesador: SoC Broadcom BCM2837B0 con núcleo cuádruple ARM Cortex-A53 de 64 bits a 1,2 GHz.
* Multimedia: decode H.264 y MPEG-4 (1080p30); encode H.264 (1080p30); gráficos OpenGL ES 2.0
* Soporte de tarjeta SD: CM3+/Lite facilita la interfaz de tarjeta SD en los pines del módulo, lo que hace posible al usuario conectar ya sea un dispositivo eMMC externo o una tarjeta SD.
* Entorno: temperatura ambiente de -20 a +70 C°.

El Raspberry Pi Compute Module 3+ se seguirá produciendo al menos hasta enero de 2024.

El Raspberry Pi Compute Module 3+ está disponible como placa independiente o como kit de desarrollo incluyendo una placa E/S Raspberry Pi Compute Module, Raspberry Pi CM3+/32GB module, Raspberry Pi CM3+/Lite module, y adaptadores de display y de cámara. Visite [Farnell element14](http://es.farnell.com/buy-raspberry-pi)en Europa, [element14](http://sg.element14.com/buy-raspberry-pi) en Asia Pacífico y [Newark element14](http://mexico.newark.com/buy-raspberry-pi)en Norteamérica.

**\*\* Fin\*\***

**Notas para la Prensa**

Encontrará más detalles e imágenes relacionadas con este comunicado en nuestra sala de prensa: [www.element14.com/news](http://www.element14.com/news)

**Acerca de nosotros**

[Newark element14](http://mexico.newark.com/) forma parte del grupo [Premier Farnell](http://www.premierfarnell.com/), un líder tecnológico global con más de 80 años como distribuidor de alto nivel de productos y soluciones tecnológicas para diseño, producción, mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos. Premier Farnell aprovecha esta experiencia para dar soporte a su amplia base de clientes, desde aficionados hasta ingenieros, ingenieros de mantenimiento y compradores como ‘The Development Distributor’ (El Distribuidor del Desarrollo), trabajando con las principales marcas y empresas emergentes en el desarrollo de nuevos productos para el mercado y el soporte a la industria para el desarrollo de la generación actual y futura de ingenieros.

Premier Farnell es una unidad de negocio de Avnet Electronics Marketing, el grupo de componentes de Avnet, Inc., (NYSE:AVT). Premier Farnell opera como [Farnell element14](http://farnell.com/) en Europa, [Newark element14](http://mexico.newark.com/) en Norteamérica y [element14](http://sg.element14.com/) en Asia-Pacífico.

Para más información, visite la web en <http://www.premierfarnell.com>

**Premier Farnell**

**Holly Smart**

**Head of PR**

Tel: +44 113 3485188

Email:[hsmart@premierfarnell.com](mailto:hsmart@premierfarnell.com)